



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H1000 高导热系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

鸿富诚 H1000 导热硅胶垫片，是一款压缩应力低的热界面材料。产品具有很好的电气绝缘特性和稳定性，防火性能高，产品表面有自然粘性，能够很好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于电子元器件产品中。

应用特点：

- 可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰色	---	目视
厚度	0.5~3	mm	ASTM D 374
硬度	50(±5)	Shore 00	ASTM D 2240
密度	3.60(±0.5)	g/cc	ASTM D 792
压缩比	≥35 (@30psi)	%	ASTM D 695
出油率	≤1	%	---
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-40~125	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	10.0(±0.5)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤0.38 (@10Psi/2mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥5	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ⁸	Ω·cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

各试验前后压缩应力测试结果比较

